沈殿型有機インヒビターによる銅単結晶の腐食抑制機構

大澤茂樹*, 國谷 勉**, 武田 誠*

(昭和61年9月5日受理)

Studies of Inhibition Mechanism of Precipitation Type Organic Inhibitors for Copper Single Crystal Surfaces

Shigeki OHSAWA*, Tutomu KUNIYA** and Makoto TAKEDA*

Abstract – The adsorption structures of mercaptan group inhibitors of 2-Mercaptopyrimigine (MPD) and 2-Mercapto-1-metylimidazole (MMI) precipitation type complexes on copper single crystal surfaces have been investigated by using IR, ATR, ¹HNMR and ESCA spectra.

The results obtained are as follows.

(1) MPD ligand forms square type structure which has MPD ligands coordinated with a copper (II) ion.

(2) MMI ligands form two types of structures, i.e. the square type structure of four ligands of MPD. In another case, MMI forms complex with copper (1) – oxide.

Sulfur in mercapto group and nitrogen in imidazole ring form coordinated bonds with each copper atom in the oxide.

Sulfur has two lone pair electrons and each lone paire electron forms coordinated bond with copper (I) – oxide. Therefore the repetition structures of complexes are formed.

From the polarization curves, protection effects for cathodic corrosion are observed in both inhibitors, and the effect of MMI is more pronounced than MPD.

1. 緒 言

銅は使用環境によって,種々の腐食を引起す。特に硫 黄化合物,シアンおよびアンモニウムイオンを含むアル カリ性溶液,硫酸および硝酸などの酸化性の酸,または 塩類により腐食される。これらの腐食を抑制するために, Bregman¹),Ashworth²)らの報告書に代表される各種 のインヒビターがある。Breston³⁾のインヒビターの定義 から3つの型に腐食抑制機構を分類できる。①酸化型イ ンヒビター,②沈殿型インヒビター,③吸着型インヒビ ターである。本研究では沈殿型インヒビターによる吸着を メルカプタン系の試薬, 2-メルカプトピリミジン, 2 ーメルカプト-1-メチルイミダゾールによって調べた。 銅表面の沈殿型インヒビターの吸着機構は*1 R, ATR, 'HNMR, ESCA*スペクトルなどの分析から解明し,防 食効果は微視的見地に立ち,腐食の際比較的に現われ易 い銅単結晶の基本三面についての分極試験により確認す ることを目的とした。

2. 実 験

2.1 試 薬

試薬には2-メルカプトピリミジンおよび2-メルカ

*茨城大学工学部金属工学科(日立市中成沢町)

Department of Metallurgy, Faculty of Engineering, Ibaraki University, Hitachi 316, Japan ** 茨城大学大学院工学研究科金属工学専攻(現,東洋曹達工業株式会社)

Graduate Student, Department of Metallurgy, Faculty of Engineering, Ibaraki University, Hitachi 316, Japan (Present, Toyosoda Manufacturing Co. Ltd.)

プトー1ーメチルイミダゾールの二種を用いた。試薬は Σ , Aldrich Chemical 社の高純度のものを使用した。

2.2 IRおよび HNMR スペクトル用試料

2.2.a *MPD-Cu*

0.1 mol/ℓのMPDのDMSO溶液に、0.1 mol/ℓ硫酸 銅エタノール溶液を等量加え、室温で反応させた後、沈 殿物を沪過し、DMSOおよびアセトンで5回以上洗浄 を繰り返し、デシケータ中で乾燥させ試料とした。

2.2.b *MMI-Cu*

0.1 mol / L MMI エタノール溶液に 0.1 mol / L の硫酸 銅溶液を等量加えた後, MPD-Cu と同様な操作を行っ た。

2.3 ATR スペクトル用試料

電気銅を圧延ロールで 0.5 mm まで圧延し真空中で 500℃, 3時間の焼鈍後, さらに圧延と焼鈍を繰り返し, ATR 装置のプリズムの上面と底面に合わせて切り標準 試料とした。試料の厚さは 0.05 mm である。また同じ圧 延銅を, 0.1 mol/ℓのMPD のDMSO 溶液に 24 時間浸 漬し, MPD のATR 試料とした。MM1についても,0.1 mol/ℓのMMI エタノール溶液において全く同様な操作 を行った。

2.4 ESCA スペクトル 用試料

Eさ1mmに圧延した銅から,3×3mmの大きさに切り出した。これを洗浄後,MPDおよびMMIの溶液に それぞれ24時間の浸漬を行った。未処理の試料につい ては,測定直前に硝酸で酸化物を取り除き純水とアセト ンで洗浄後測定した。

2.5 単結晶の作成

純度 99.997%の電気銅を用い,単結晶を作成した。 炉内雰囲気は真空(3×10^{-6} torr)で,1100°C に保持 し,炉の移動速度は、8 cm/hとした。まず初めに黒鉛 ボートで、 $20 \times 20 \times 50 mm^3$ の単結晶を作成し、X線背 面ラウェ法により面を決定し、放電加工機で(100)、 (110)、(111)の各面をそれぞれが持つように、 2×2 ×30 mm³に切り出し種結晶とした。種結晶は黒鉛ボート で上面に基本面を持つ単結晶 $30 \times 50 \times 2.5 mm^3$ にそれぞ れ作成した。

2.6 分極試験試験片

単結晶をアセトンおよび硝酸で油脂や酸化物,不純物 を除去し, X線により面の確認を行った。その後放電加 工機により, 15×15 mm^2 に切り出し,これを耐水研摩 紙# 800~1500まで水性研摩し,さらにダイヤモンド ペースト, 30~0.1 μ で鏡面研摩後,燐酸 45% 水溶液 で冷却,撹拌しながら6 V,1分間の電解研摩をした⁴⁾。 研摩終了後,真空雰囲気で 500°C 3 時間の焼鈍を行った。 これらの試験片を,導線と銀ペーストで接着し,研摩面 以外を試料埋込用樹脂で固定した。固定した試料をさら に,耐水研摩紙,ダイヤモンドペーストの順で研摩後, 電解研摩して,エタノールおよび純水で洗浄後,インヒ ビター処理を行った。

MPD処理は 0.1 mol/ℓのMPDのDMSO溶液を数滴滴 下し処理した。この時点での溶液のpHは 8.0 であった。 MMI処理は 0.1 mol/ℓのMMI エタノール溶液中に室 温において浸漬して処理した。処理時間はMPD, MMI ともに1時間および 24 時間とした。

2.7 EPMA 用試料の作成

厚さ2mmに厚延した銅から $10 \times 10 mm^2$ の大きさに 切り出した後、樹脂に固め、研摩および試薬処理を2.6 の操作と同様に行い試料とした。ただし浸漬時間は24 時間とした。

2.8 測定方法

2.8.1 IR およびATR スペクトル

結合状態を知るための*IR*スペクトルは日本分光*A*-102型赤外分光光度計を使用し,*KBr*錠剤法により測定 した。*ATR*スペクトルは,日本分光*A*102型の分光計に, 日本分光*ATR*-6型, *Multipul Reflection Single Beam*を組合せて測定した。

2.8.2 'HNMRスペクトル

試薬および試料の[']HNMR スペクトルの測定には Perkin-Elmer Model-I 日立 20B型, 核磁気共鳴装 置を用いた。溶媒にはDMSO-d₆, 基準物質にはTMS を使用した。

2.8.3 ESCAスペクトル

結合状態をさらに詳しく検討するために光電子スペクトルを測定した。測定には島津製作所 *Electron Spectrometer ESCA*-750を使用し,データシステムには 同社製の*ESCAPAC*-760を組み合せた。X線は*MgK*α 線,強度は8kV,30mAにおいて0~1170eVのエネ ルギー範囲を測定した。

2.8.4 分極試験

腐食電流の測定は電解装置として,北斗電子工業のポ テンショスタットHA-305型を使用した。参照電極には, ルギン毛管付塩化水銀電極を用い,対極には200mm²の 白金板を使用した。

掃引は,自然電位から正電位側へ0.005∨間隔で1分間の分極を行いアノード測定とし,カソードは負電位側へ0.020∨間隔で2分間分極させた際の電流値を測定して,電位と電流の関係を求めた。

腐食液は3%塩化ナトリウム水溶液をpHを7に調整 した。また,測定に酸素除去の窒素を吹込み,酸素の影響を除いた。浴温は25℃恒温とした。

データ処理には、パーソナルコンピュータを使用した。 2.8.5 *EPMA*

走査型電子顕微鏡による表面観察は島津製作所X線マ イクロアナライザEMXSMを使用し,加速電圧75kVに おいてのSEM 像を比較した。

3.結果と考察

- 3.1 / Rおよび ATR スペクトル
- 3.1.a *MPD*および *MPD*-*Cu*

MPD およびMPD-Cuの IR スペクトルとMPD-Cu のATRスペクトルをFig1に示す⁵⁾。MPDのスペクト ルには 740, 750, 790, 980 cm^{-1} に δCH 面外変角振動 が現われている。また 1050, 1100, 1180, 1210 cm^{-1} に*るCH* 面内変角振動が, 1330, 1420, 1560, 1600cm⁻¹ にはCullerton⁶⁾. Katritsky⁷⁾によって指摘されたv $ringh^{s}$. 1905, 1975, 2500, 2600 cm^{-1} icit $\nu S-Hh^{s}$ それぞれ現われている。これと比較してMPD-Cuには 山口ら⁸⁾によって報告された $\delta Cu-S$ が660 cm^{-1} に現 われ、 $\delta C - H$ が1020、1118 cm^{-1} に、 ν ring 環振動 が1370,1403,1550 および1643 cm⁻¹に現われてい る。ここで注目すべきことが2つある。① MPD に現わ れている*vS-H*の吸収帯が*MPD-Cu*では消失してい る。②*MPD-Cu*の660cm⁻¹に*MPD*には現われなかっ た **δ Cu-S**が現われていることである。これらの吸収帯 の生成と消失はメルカプト基の水素が銅と置換している ことを示している。次に金属表面のMPD-CuのATRス ペクトルをMPD-CuのIRスペクトルと対比させたと ころ全く一致した吸収帯が得られた。このことは沈殿型

錯体が金属表面に吸着していることを示唆するとともに, その構造が*MPD-Cu*錯体の構造と全く同じか,もしく は酷似していることを示している。これらの吸収帯と構 造との関係を表1に示す。

3.1.b *MMI* および *MMI-Cu*

MMI および*MMI-Cu* の*IR* スペクトルと金属表面 に吸着した*MMI-Cu* 錯体の*ATR*スペクトルを*Fig* 2 に示す。*MMI* のスペクトルには 800, 1055 cm⁻¹にる *C-H*, 1190 cm⁻¹に ν C-S, 1500, 1570 cm⁻¹には ν ring^{6),7)}が, 2500 cm⁻¹には ν S-H が現われている。 これと比較して*MMI-Cu*のスペクトルには 770 cm⁻¹



Fig. 1 Infra-red absorption spectra of MPD-Cu and surface film on cupper. ———— MPD-Cu in KBr disk. ————— Reflectance spectrum. —————— Blank.

Table 1 The peaks of MPD IR spectra.

Wave Number (MPD)		Assignment	Wave (MPD-	Number -Cu)
		Deformation Cu-S	660	(W)
680	(W)	Stretching C-S	700	(S)
740 750 790 980	Out (S) (S) (S) (S)	of Plane Deformation C-H	740 750 798 950	(S) (S) (M) (M)
1050 1100 1180 1210	(S) (S) (W) (S)	Inplane Deformation C-H	1020 1118 1165 1237	(S) (S) (W) (W)
1330 1420	(S) (M)	Ring Stretching	1310 1430	(W) (W)
1560 1600	(S) (S)	Ring Stretching	1550 1645	(S) (M)
1905 1970 2500 2600	(M) (M) (W) (W)	Stretching S-H		





 $i \subset \delta C u - S \, b^{\sharp}$, 890, 982 $c m^{-1} i \subset \delta C - H$, 1090 $c m^{-1}$ に $\nu C-S$, 1483, 1568 cm^{-1} に $\nu ring$ が現われている。 これらのスペクトルについて注目に価することは、MMI の $2500 cm^{-1}$ に現われていた $\nu S - H i MM I - Cu$ には 消失しており. 770 cm⁻¹に新しいδCu−S の吸収帯が 現われている点である。これはMPDと同様にメルカプ ト基の水素が銅と置換していることを示している。スペ クトル全般に. MMI-Cuでは吸収帯が極めて現われ 難くなっており、総ての吸収帯が低波数側にシフトして いる。これは銅との結合のためイミダゾール環が著しく 歪められているからである。MMI-Cu と金属表面の 沈殿型錯体のATRスペクトルとが対応すれば、MMI-Cu 錯体と金属表面に吸着させたMM I-Cu 錯体とが同 一構造をとることを示す。そこでこれらの吸収帯の比較 から得られた結論は、ATRスペクトルには、 $825 \ cm^{-1}$ に、 $\delta Cu - N$ の吸収帯があり、この吸収帯はMMI - Cuの / R スペクトルには見られないものである。このよう にATRスペクトルとIRスペクトルの異なりは、この 沈殿型錯体が異なった吸着構造をとっていることを示唆 している。これらの吸収帯と構造との関係を表2に示 す。

3.2 [/]HNMRスペクトル

3.2.a MPDおよび MPD-Cu

Fig.3にMPD およびMPD - Cu の 'HNMR スペク トルを示す。MPD の 1.8 τ に 現われている二重線は環 プロトンの a - Hによるものであり, 3.1 τ の三重線は環

Table 2 The peaks of MMI IR spectra.

					the second s
Wave Number (MMI)		As	signment	Wave Number (MMI-Cu)	
		De	formation Cu-S	770	(W)
800	(S)		C-H	890	(W)
1055	(S)			982	(M)
		St	retching		
1190	(S)		C-H	1090	(S)
1500	(S)	Ring	Stretching	1483	(W)
2500	(W)	St	retching S-H		



Fig. 3 ¹H NMR spectra of MPD, MPD-Cu, MMI, and MMI-Cu.

プロトンの *b* -*H*によるものである。6.5 τ に見えるブ ロードなシグナルは*S* -*H*である。

これと比較してMPD-Cuのスペクトルには,環プロ トンのシグナルが消失している。これは配位化合物を作 ることにより,電子スピン緩和時間が長くなり,シグナ ルの線幅が広くなるためである⁹⁾。特にCu²⁺はこの時 間が長いために線幅を広げる効果が著しい⁸⁾。よってシ グナルの線幅が広すぎて見えないことが多い。シグナル のみかけ上の消失はMPD-Cuを生成することにより起 る。

3.2.b *MMI*および*MMI-Cu*

Fig. 3 にMMI およびMMI-Cu の 'HNMR スペクトルを示す。MMI のスペクトルの 30 で付近に, 二重線 のシングルが二種類現われている。これは環プロトン。*a* -Hおよび *b* -Hのシグナルである。また6.6 での鋭いシ グナルは**S – H**である。

これと比較して*MMI-Cu*のスペクトルにも,広いシ グナルの線幅によるみかけ上の消失がある。それが環プロト ンのシグナルの遮蔽となって現われている。8.0 でには, *MMI* のスペクトルにはみられなかったシグナルが現われてい るが,これは*CH*3のシグナルであり, *MMI*の*CH*3は溶 媒和により超共役の型をとりシグナルの共鳴は起らなか ったと考慮できる。

3.3 ESCA スペクトル

IR スペクトルとATR スペクトルでMMIの金属表面 における錯体の構造を解析したが,その沈殿型吸着モデ ルをさらに詳しく調べるために,光電子スペクトルを測 定した。

銅, MPD-Cu, MMI-Cu, MPD, MMIの各ワイ ドスキャン(測定範囲: 0~1170eV) Fig. 4 に示す。 銅のスペクトルは, 951eVに $Cu_{2P1/2}$, 931eVに $Cu_{2P3/2}$, 415 および 335eVに Cu_{LMM} , 120eVに Cu_{35} , 74eVに Cu_{3P} , 2eVに Cu_{3P} がピークとして現われている。これ は銅の総てのピークであり,表面状態の条件が良好であ ることを示す。

*MPDとMMI*のスペクトルは、 $399eV \approx N_{1S}$, 135 $eV \approx S_{2S}$, 163 $eV \approx S_{2P}$ が現われる。*MPD*-Cuのスペ クトルは銅と*MPD*の重なったスペクトルであるが、 MMI-Cuの場合,535eVに O_{1S} のスペクトルが現わ れる。これはMMI-Cuの結合に酸素が関与し,MMI $-Cu_2O$ の結合であることを示している。Fig.6にナロ-スキャンを示す。これは $MPD \ge MPD-Cu$ の S_{2P} およ び N_{1S} の対比であり,MMI-Cuの S_{2P} および N_{1S} の 対比である。このスペクトルから S_{2P} のピークがMPDで161.8eV,MPD-Cuで,1.4eV高エネルギー側にシ フトし、163.2eVに現われる。フェルミ基準では164、 165eVで1eVの差で $S_{2P} 3/2 \ge S_{2P} 1/2$ が現われる。こ のことを考慮してスペクトルの分離から結合による影響 が確認できる。Fig.6に示すナロースキャンではMMI $\ge MMI-Cu$ のスペクトル分離が $S_{2P} 3/2 \ge S_{2P} 1/2$ で良 いことが結合後の状態で良いことを示す。

 $N_{1S \ L/2}$ スペクトルは,岸,池田¹⁰, Yates G^{11} のNO, N₂ の吸着に関する報告から,低エネルギー側のスペクトルはMMI - Cuの場合,イミダゾール環のS およびNにも結合していることが確認される。

Fig. 5 のMPD-Cu, MMI-Cu の銅スペクトルと の比較から, MMI-Cu の場合Cu₂O(I)にMMIの結合 するMMI-Cu₂Oの状態を確認できる。それは金子の Cu₂OのXPSの化学シフトデータによる結果から,Cu₂O の化合物はXPSでは化学シフトを示さない^{12)13)14)15)16) ことを考慮して, ワイドスキャンに見られる酸素から MMI-Cu₂Oであると結論ずける。}



Fig. 4 ESCA WIDE SCAN.





3.4 沈殿型錯体の吸着構造

IR, ATR, 「HNMRおよびESCA等の各分析結果よ り考察したMPDとMMIの銅表面の吸着構造は, MPD においてはメルカプト基のHと置換して,四配位平面正 方型構造をとり, MMIにおいてはNおよびSと結合し て四配位平面正方型の構造をとることが確認された。な お, MMIではATRおよびESCA分析がMMI-Cu2O の構造を示唆している。一般に溶液と金属表面の反応で は錯体のみを作らない。本研究は最初錯体を作製して, 金属表面に吸着させることを目的としたので, 沈殿型錯 体の金属表面への吸着構造の効果を求めた。

3.5 分極試験による防食効果の測定結果

一般に分極曲線は防食効果を判定するための一つの目 安である。銅の場合は,典型的な陰極支配型であるの で¹⁷,陽極反応抑制には期待を持てない。金属結晶の格 子面では,原子密度の大きな面ほど安定で不活性であ る¹⁸)。銅においては(110),(100),(111)の順に安定

である。そこで面の違いによる影響を調べるため、各面 における分極曲線を求めた。Fig.7 に銅の三面(110), (100) (111) の分極曲線を示す。陽極側は差異は認 められず, 陰極側に明確に面による違いが現われる。結 晶構造から明示されるf.c.c 結晶における面密度は (111)>(100)>(110)の順で低くなるが、分極曲線 からも面密度が低い程腐食され易い結果が得られている。 MPDとMMIの反応時間の違いを調べるのにFig.7,8 に処理時間の違いによる各面での防食効果の比較を示す。 MPDでは24時間浸漬が優れた防食効果を示す。陰極 側は特に効果があり、各面ともに24時間浸漬が良好な 結果を得ている。陽極側は(100)面のみ効果が現われ る。MPDとMMIの防食効果の比較から得られた結論 はMPDは(100)面の陰極に効果を示し, MPD およ びMMIの陰極型のインヒビターの確認になる。MMI は(111).(110)面に効果がある。インヒビターとし ての試薬の自然電位は貴側に現われる。Fig.7 および8 に各面についてのMPDとMMIの防食効果の違いを示 した。(100)面ではMPD の方がはるかに高い防食性 を示す。(110)面ではMMIの方が効果を示し(111) 面についてはMMIの方が腐食を効果的に抑制する。こ れは試薬の吸着構造と銅の原子間距離に関係する。MPD の防食効果は(100)>(110)>(111)の順で効果が あった。MMIの防食効果は(111)>(100)>(110) の順であった。銅の面密度は(111)>(100)>(110) であるから、MMIは面密度の高い方が吸着に適する。

3.6 EPMA による表面観察

EPIMAによる未処理の銅表面を 6.6 μ m/cmの倍率で 観察すると表面は均一で滑らかである。24 時間処理し た表面をそれぞれ 20 μ m/cm, 6.6 μ m/cm, 2.0 μ m /cmの倍率で観察し,未処理の表面と比較すると,金 属表面でなく析出層である。この析出層は多孔質で腐食液 の攻撃を受ける機会が多い。*MMI*の24 時間処理を施 した表面の 6.6 μ m/cm, 2.0 μ m/cmの倍率から得ら れた結果は表面に孔食がみられた。これは Mattson, Campbel/¹⁹⁾²⁰⁾²¹⁾の吸着時に起こる孔食に関する報告 によるものと同じである。この孔食を防ぐには,溶液濃 度および pH による吸着条件が工夫されるところであ る。









4. 結 論

IR, **'HNMR**, **ESCA**スペクトルなどの解析結果お よび分極試験から, **MPD**と**MMI**の銅に対する性質が 次のように明らかになった。

- (I) MPDによる沈殿型錯体は四配位の平面正方型構造 をつくる。MMIもMPDと同様に四配位の平面正方 型構造を作るが,銅表面に酸化物が存在する場合,酸 化銅(I)と結合し、繰返し構造をつくる可能性が高い。
- (凹 MPDよりもMMIの方が反応時間は短かい。また 試薬の性質により、その効果は異なり、MPD につい ては、(100)>(110)>(111)であり、MMIで は(111)>(100)>(110)であった。これは試薬 の吸着構造に、銅の各面における原子間距離が関係し て、効果の違いとなって現われる。総合的な見地から MPDよりもMMIの方が優れた防食効果が表われる。
- (四) MPD の表面は折出層に覆われ厚く,粗い。MMI の表面は平坦で非常に滑らかであるが,24時間0.1 mol/L 溶液に浸漬処理を行うと孔食が発生する。

References

- J. IBregman ; Corrosion Inhibitors, Ma Cmillan New York (1963)
- V. Ashworth, C, Lkokoszki and N.H. Tahala ; Proceeding of 6ICMC p634(SYDNEY, 1975)
- J.N. Breston ; Ind. and Eng. Chem., 44, 1755 (1952)
- 4) S.Fujii ; Corrosion, 11, 100 (1962)
- 5) IR SCOT.
- 6) Cullertson et al. J.A.C.S., 24, 4834 (1952)

- 7) Katritsky et al. Spectoro Chem., 20, 593 (1964)
- 4) 山口正雄, "赤外線吸収スペクトル"化学の領域, Vol. 4, P.86, 南江堂
- 8) Luttle et al. Z. Electrochem. 64, 650, (1960)
- H.M.Randll et al. "Infrared Detemination of Organic structures", Van Nostrand(1949)
- 9) H.A.Szymansky, "NMR Band Handbook" P. 348, IFI/PLENUM; NEW YORK-WASHINTON, (1968), 2727.
- 10) K.Kishi, S. Ikeda ; J. Phys. Chem., 78, 107 (1974)
- 11) T.E. Madey, J.T. Yates. Jr, N.E. Erickson; Surface sci., 43, 526 (1974)
- 12) 金子英隆, 金属表面, 29, 8, 425(1978)
- 13) C.D.Wagner ; Faraday Discuss. No.60, 291 (1975)
- 14) N.S. Mcintyre et al. J. Electro Chem. Soc., 123, 1164 (1976)
- 15) P.E.Larson; Ibid. 4, 213 (1974)
- 16) Hammond et al. J. Electro. Chem. Soc., 124 (1977)
- 17) D.C. Frost et al. Mol Phys., 24, 861 (1972)
- 18) E.Mattsson et al. Brit. Corros. J., 3, 246 (1968)
- H.S. Campbell et al. "Galvanic & Pitting Corrosion" ASTM STP 576, ASTM 155 (1976)
- P. Devroey et al. FinalReport to International Copper research Association Inc. Oct. (1970)
- N.R. Bharucha, British Non-Ferrous Metals Research Association, Report, July, (1966)